

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年10月18日(2012.10.18)

【公開番号】特開2010-141294(P2010-141294A)

【公開日】平成22年6月24日(2010.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-025

【出願番号】特願2009-241235(P2009-241235)

【国際特許分類】

H 01 L	27/12	(2006.01)
H 01 L	23/52	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	27/08	(2006.01)
H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/088	(2006.01)
H 01 L	27/00	(2006.01)
H 01 L	21/02	(2006.01)
H 01 L	21/3205	(2006.01)
H 01 L	21/768	(2006.01)
H 01 L	23/522	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/12	C
H 01 L	29/78	6 1 3 Z
H 01 L	29/78	6 2 7 D
H 01 L	29/78	6 1 9 A
H 01 L	27/08	3 3 1 E
H 01 L	27/08	1 0 2 E
H 01 L	27/00	3 0 1 C
H 01 L	27/00	3 0 1 B
H 01 L	27/08	1 0 2 D
H 01 L	27/12	B
H 01 L	21/88	T
H 01 L	21/90	J
H 01 L	21/90	A
H 01 L	23/52	C

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月5日(2012.9.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の基板上に第1の分離層を形成し、

前記第1の分離層上に第1の半導体素子層を形成し、

前記第1の半導体素子層及び前記第1の分離層に第1のレーザビームを照射することにより、前記第1の半導体素子層及び前記第1の分離層の一部を除去して開口部を形成し、

前記開口部に、前記第1の半導体素子層と電気的に接続する第1の配線を形成し、
前記第1の半導体素子層上に第1の保護材を形成し、
前記第1の保護材中に、前記第1の配線に電気的に接続する第1の電極を形成し、
前記第1の分離層に沿って、前記第1の基板と、前記第1の保護材が形成された前記第1の半導体素子層と、を分離し、
第2の基板上に第2の分離層を形成し、
前記第2の分離層上に第2の半導体素子層を形成し、
前記第2の半導体素子層及び前記第2の分離層に第2のレーザビームを照射することにより、前記第2の半導体素子層及び前記第2の分離層の一部を除去して開口部を形成し、
前記開口部に、前記第2の半導体素子層と電気的に接続する第2の配線を形成し、
前記第2の半導体素子層上に第2の保護材を形成し、
前記第2の保護材中に、前記第2の配線に電気的に接続する第2の電極を形成し、
前記第2の保護材上に、前記第2の電極と前記第1の配線が電気的に接続されるよう、前記第1の半導体素子層を貼り合わせ、
前記第2の分離層に沿って、前記第2の基板と、前記第2の保護材が形成された前記第2の半導体素子層及び前記第1の保護材が形成された前記第1の半導体素子層と、を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

請求項1において、
前記第1及び第2の保護材は、それぞれシート状纖維体に有機樹脂が含浸された構造体であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、
前記第1及び第2の電極は、それぞれ導電性樹脂であることを特徴とする半導体装置の作製方法。